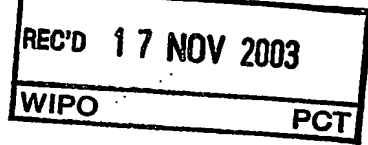




**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**



Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°
02292649.7

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:
Application no.: 02292649.7
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 24.10.02
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

SCHLUMBERGER Systèmes
50, avenue Jean Jaurès
92120 Montrouge
FRANCE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Support de données

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

G06K19/00

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

Support de données.

1. OBJET

- La proposition de brevet concerne un nouveau mode de fabrication des « plugs »
5 (partie de carte ISO qui se positionne dans un téléphone mobile). Un plug comprend
un corps dans lequel est inséré un module. Un module comprend un circuit intégré
connecté à des plages de contacts en utilisant des fils conducteurs ou la technique flip
chip. Un module comprend généralement de la résine protectrice.
Ce mode de fabrication est basé sur le principe que seul le plug est livré au client (le
10 support graphique assuré par la carte ISO est supprimé).

2. PRESENTATION GENERALE

2.1 MODE DE FABRICATION ACTUEL :

Voir figure 1

- 15 Un module (1) fini est encarté dans une carte (2) sur laquelle est découpé un plug (3).
Ce plug(3) est ensuite détaché de la carte (2) pour être utilisé.

2.2 PROPOSITION DE NOUVEAU MODE DE FABRICATION DU PLUG

Voir figure 2 .

- 20 Etape 1 : La carte (1), vierge au départ, est imprimée (visuel publicitaire).
Etape 2 : 4 cavités (2) sont réalisées dans la carte (par fraisage par exemple). Il s'agit
de cavité avec deux profondeurs (1ere cavité pour le trottoir de collage, seconde
cavité pour l'enrobage la puce enrobée).
Etape 3 : Des modules finis (3) (avec puce câblée et enrobée) sont découpés dans la
25 bande de modules finis pour être encartés dans les cartes imprimées et fraisées.
Etape 4 : Personnalisation : Les modules encartés sont personnalisés
(personnalisation logicielle + personnalisation graphique sur le plug).
Etape 5 : Cette étape consiste à découper des pointillés(4) pour pouvoir découper le
plug à la taille 3G

Etape 6 : Plugging : Cette étape consiste à découper les plugs(5) dans la carte, de manière à les désolidariser.

Etape 7 : Cette étape permet de vérifier l'ordre des plugs personnalisés ; En effet, les plugs, une fois personnalisés doivent être livrés au client dans l'ordre et sans trous dans la numérotation.

Etape 8 : Mailing : Cette étape consiste à mettre le plug dans un encart qui lui est associé.

3. VARIANTES

10 Le procédé de fabrication est exposé ici pour des cartes que l'on va fraiser. On peut imaginer ce type de procédé à partir de cartes moulées.

La description ci-dessus mentionne des cartes comprenant 4 plugs. Plus généralement elle concerne des cartes comprenant au moins 2 plugs.

15 Le procédé est ici exposé en introduisant l'option « plug 3G » qui permet de diminuer la taille du plug si besoin est afin de l'adapter à de nouvelles tailles de plugs. Cette possibilité reste une option, et le procédé reste valable sans avoir l'option 3G.

Une autre alternative serait de ne faire que 2 plugs par carte, mais 1 sur chaque face (en opposition). Ce système permettrait de limiter les modifications machine
20 (investissements limités) en conservant la configuration standard.

L'invention concerne des cartes comprenant au moins deux plugs. Plus généralement elle concernant des couches supports comprenant au moins deux supports électroniques d'information qui sont détachables. Un support électronique
25 d'information comprend un corps support dans lequel est inséré un circuit intégré qui est arrangé pour stocker et/ou traiter des données.

4. BILAN

L'invention concerne une couche support caractérisée en ce qu'elle comprend au moins deux supports électroniques d'information, les supports électroniques d'information étant détachables de la couche support.

- Au lieu de fabriquer un seul plug à partir d'un corps de carte, ce procédé de fabrication permet de faire plusieurs plugs sur un seul corps de carte => économie de matière
- 10 ▪ Ce procédé permet de gagner du temps lors des différentes étapes de fabrication (fraisage, encartage, personnalisation....) car le même support mécanique contient plusieurs supports électroniques, les machines peuvent fonctionner à des cadences plus élevées.

15

Revendications

1. Couche support caractérisée en ce qu'elle comprend au moins deux supports électroniques d'information, les supports électroniques d'information étant
- 5 détachables de la couche support.

BEST AVAILABLE COPY

